

# 导电胶 ECA20

## Electronic Conductive Adhesive ECA20

### 产品概述

ECA20 是一款双组分环氧导电银胶，专门为微电子和光电应用中的芯片粘接而设计。由于该产品有高的热传导率，因此它也被广泛的应用于热处理方面。在过去的许多年中，它已经证明了它自身的可靠性，它还是新应用中传导胶的精品。特别推荐，用于高速环氧芯片粘接系统，那里需要快速固化。用在塑料制品 IC 包装中，符合 JEDEC III 和 II。可耐受 300°C 到 400°C 的热压打线结合温度。使用方便；可用于分配，丝网印刷，移印或手工操作。特别适用于高能装置和高电流应用和高能 LED。光电包装物质：LED, LCDs, 和光纤部件。

注意：不使用时，将容器密封好。对于填充系统，在双组分混合前，要充分搅拌每个容器中的产品。

### 固化前产品特性

外观	银灰色粘稠液体
密度 (ASTM D792, g/cm <sup>3</sup> )	A 组份 2.03/B 组份 3.07
1:1 混合粘度 (@10RPM/25°C, cPs)	20000~30000
触变指数	4.63
常温使用寿命 (小时)	24
存储寿命 (-40°C, 天)	365

### 产品固化条件

175°C	45 秒
替代固化条件	15 分钟@150°C, 30 分钟@120°C, 3 小时@80°C

### 固化后产品特性

项目	测试方法	单位	数值
玻璃化温度 (T <sub>g</sub> )	TMA	°C	>80
热膨胀系数 T <sub>g</sub> 以下	TMA	ppm/°C	31
热膨胀系数 T <sub>g</sub> 以上	TMA	ppm/°C	158
导热系数	Laser Flash	W/mK	2.5
体积电阻	--	Ohm/cm	<=0.0002
热失重	TGA @300°C	%	0.35
饱和吸水率	85°C/85RH	%	0.6
剪切强度	2*2mm Si die on Ag/Cu LF	Kg (25°C)	>=3.5
剪切强度	2*2mm Si die on Ag/Cu LF	Kg (150°C)	>=2.8
剥离强度	--	N/mm <sup>2</sup>	7.0
操作温度	--	°C	-50~200

### 产品包装及货期

包装	A: 10g、20g/B: 10g、20 罐装
最小包装量 (MPQ)	A: 10g、20g/B: 10g、20 罐装
最小订单量 (MOQ)	A: 10g、20g/B: 10g、20 罐装
交货期 (L/T)	10-20 个工作日